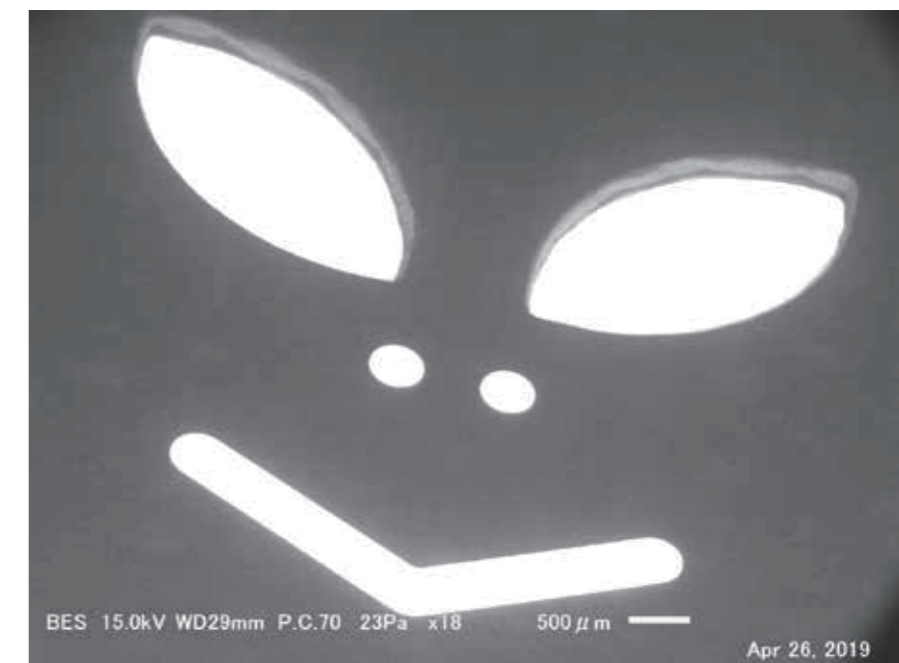
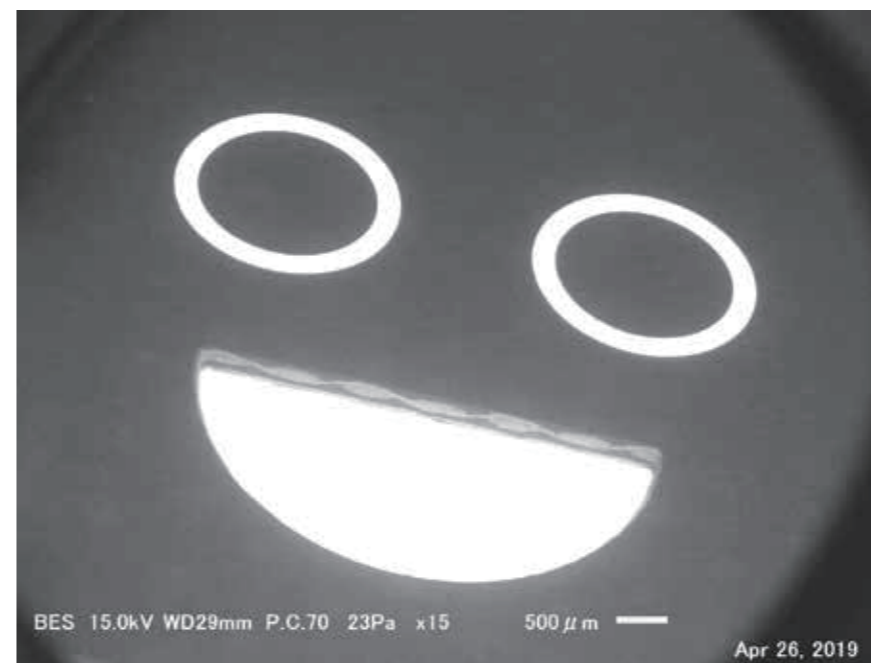


高放熱&低損失対応基板

高周波パワーモジュールの放熱対策に貢献します

ザグリ(ドリル):単穴

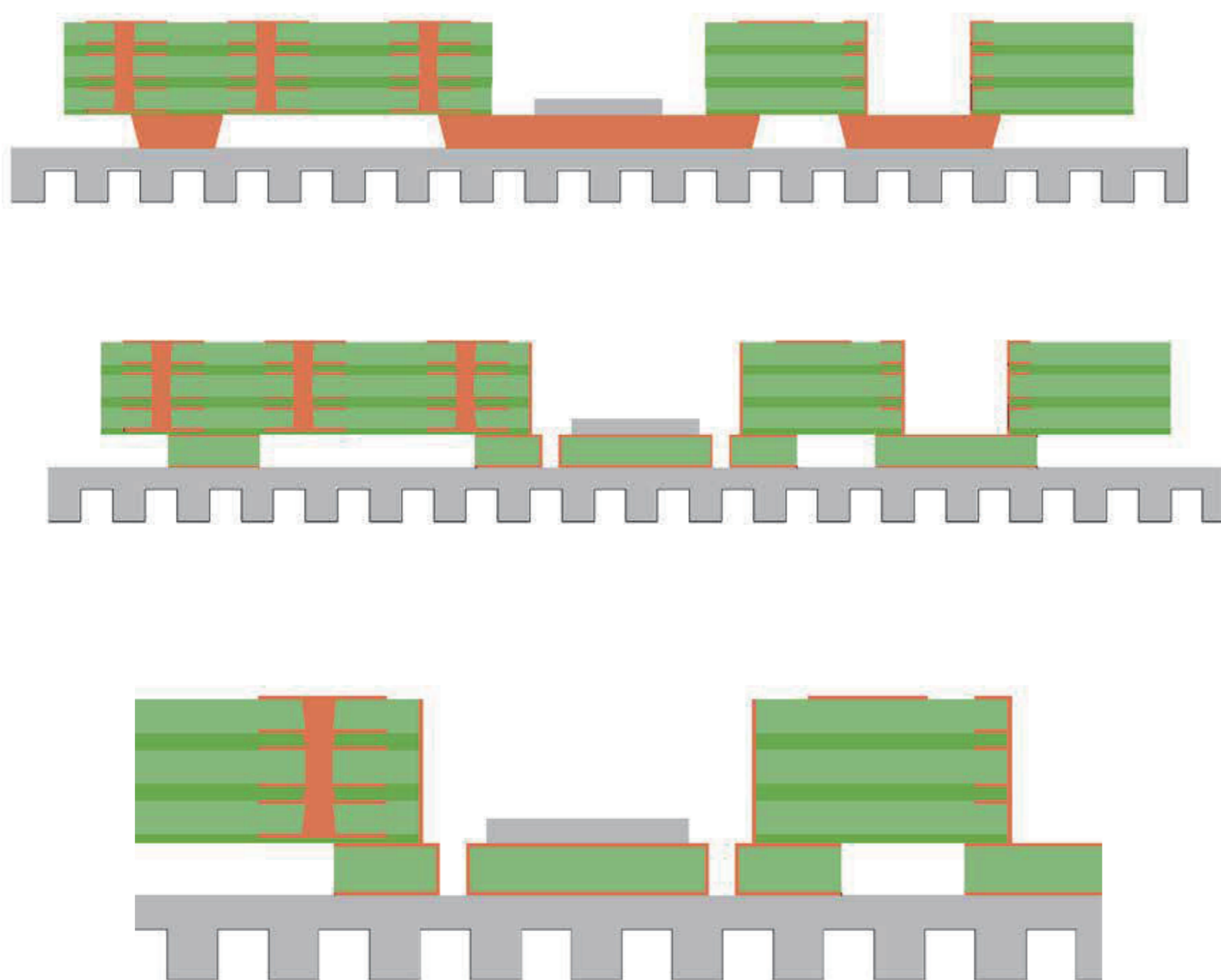


ザグリ 断面構造図

ザグリ(レーザー):ニコちゃんのお口

ザグリ(レーザー):エイリアンの目

層構成



SPEC

- ◇優れた放熱特性
→ 銅へのダイレクト放熱
- ◇高周波対応材料を選択可能
→ 高周波対応材料については種々の加工実績有り
→ コア材、PP材に高周波対応材を使用して高周波対応のパワーアンプ向け基板を製造
- ◇コア材+PP材+銅板
※コア材部は複数層可能
- ◇コア材、PP材は選択可能
- ◇銅板厚み: ~0.25mmの回路形成
- ◇表面处理: 無電解Ni/Pd/Au、etc.

- ◇ザグリ部を利用して銅ベース直上に実装可能
- ◇ザグリ加工可能な設備を多数保有しており、仕様により最適なお提案を致します。
(レーザー/ルータードリル(Z軸制御有り)/NCドリル(Z軸制御有り))
- ◇テンディング法ではなく、パターンめっき法で回路作成を行うことでランド幅を小さくすることが可能となります。
→ ベアチップからの距離を狭くする設計が可能となります。